

# 東京エレクトロン

## 2009年3月期第1四半期 決算説明会

2008年8月8日

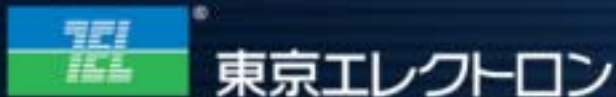
### 資料取扱い上の注意

#### 将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

#### 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



# 2009年3月期第1四半期 決算概要

経理部長 佐伯幸雄

2008年8月8日

## 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

# 当第1四半期の業績

(単位: 億円)

	2008年3月期				2009年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	対前年増減
<b>売上高</b>	2,124	2,638	1,998	2,298	1,548	27.1%
SPE	1,657	2,134	1,607	1,864	1,125	32.1%
FPD	214	222	100	143	172	19.3%
EC/CN	251	280	289	289	249	1.0%
その他	1	1	0	1	0	29.5%
<b>売上総利益</b>	765 (36.0%)	887 (33.6%)	724 (36.2%)	735 (32.0%)	520 (33.6%)	32.0%
<b>販管費</b>	335	368	339	385	306	8.6%
<b>営業利益</b>	430 (20.3%)	519 (19.7%)	384 (19.3%)	349 (15.2%)	214 (13.8%)	50.2%
<b>経常利益</b>	411	546	397	371	222	45.9%
<b>税前利益</b>	424	557	400	310	222	47.6%
<b>当期純利益</b>	261	362	256	182	128	50.9%
<b>研究開発費</b>	148	170	159	182	145	2.0%
<b>設備投資額</b>	70	57	41	57	55	20.9%
<b>減価償却実施額</b>	46	51	55	60	51	10.1%

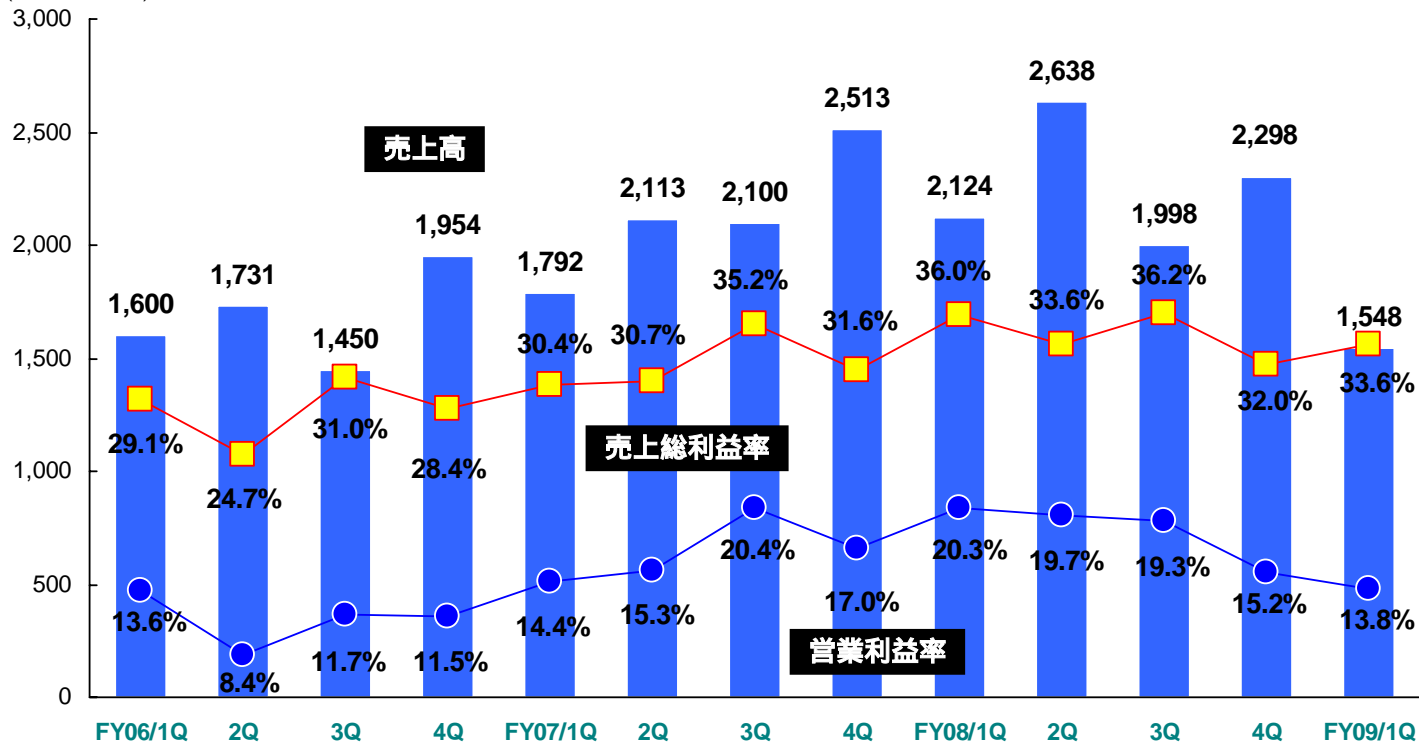
SPE: 半導体製造装置, FPD: FPD製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク



# 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

## 売上・利益率推移

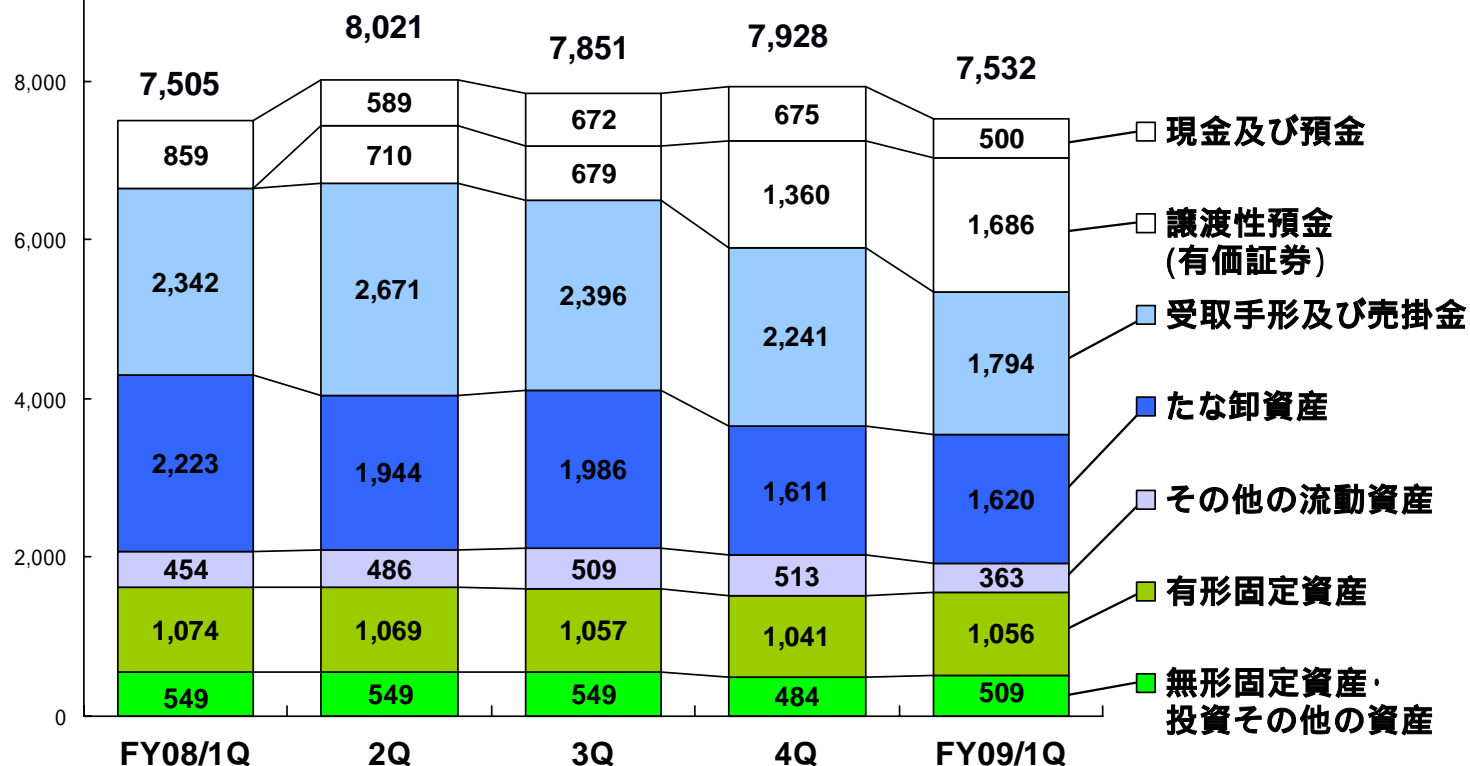
(単位:億円)



## 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

# 資産

(単位:億円)  
10,000



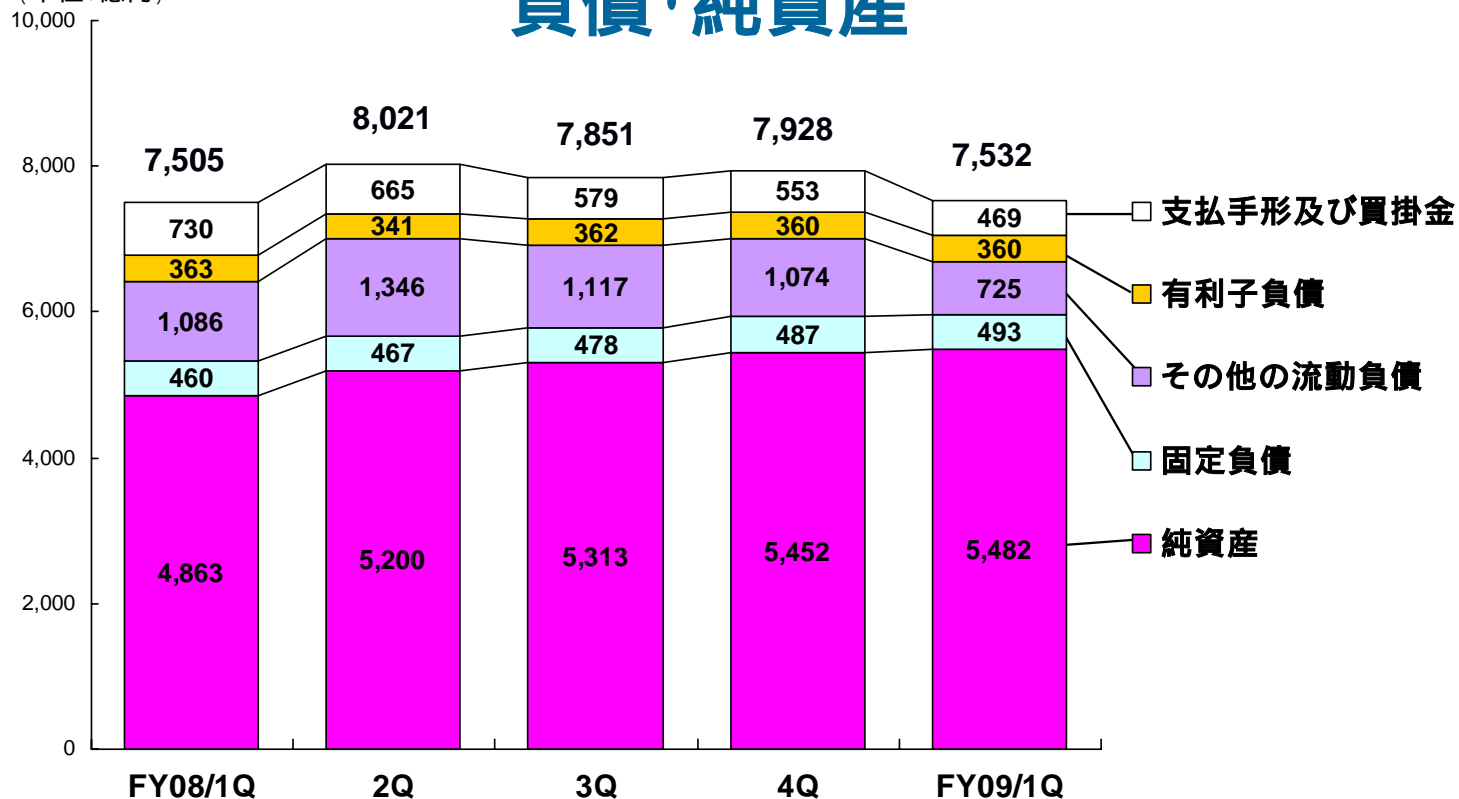
\*従来、「現金及び預金」に含まれていた「譲渡性預金」は、FY08/2Qより区分して表示しております。



## 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

# 負債・純資産

(単位: 億円)



有利子負債/自己資本

7.6%

6.7%

7.0%

6.7%

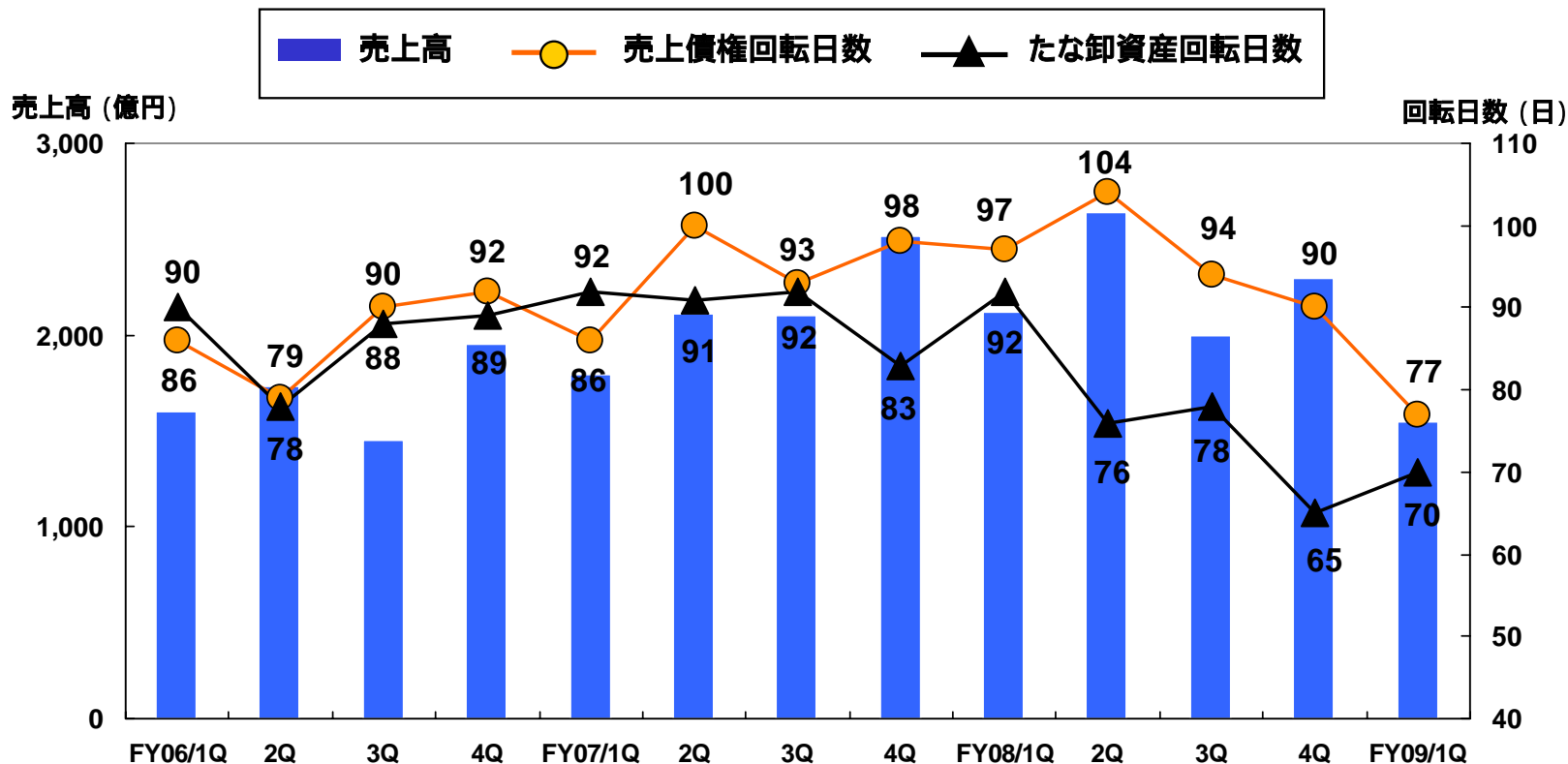
6.7%

\* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権 + 少数株主持分)



# 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

## たな卸資産・売上債権の回転日数



\*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

\* FY2006/1Qの回転日数算出に使用したFY2005/2Q売上高 = 新会計方針によるFY2005/1Hの売上高 ÷ 2



## 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

# キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2008年3月期					2009年 3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	合計	1Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	295	500	206	756	1,169	346
投資活動によるキャッシュ・フロー	46	39	389	173	301	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	142	21	104	2	270	100

現金及び現金同等物の増加額	484	439	287	923	591	240
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

現金及び現金同等物の期末残高	859	1,299	1,011	1,934	/	2,176
----------------	-----	-------	-------	-------	---	-------





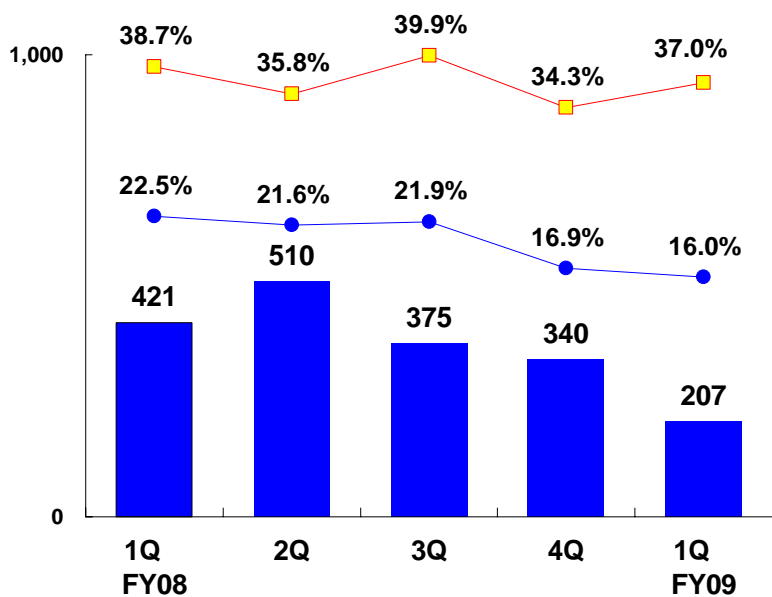
# 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

## 事業の種類別セグメント情報

**産業用電子機器**  
(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

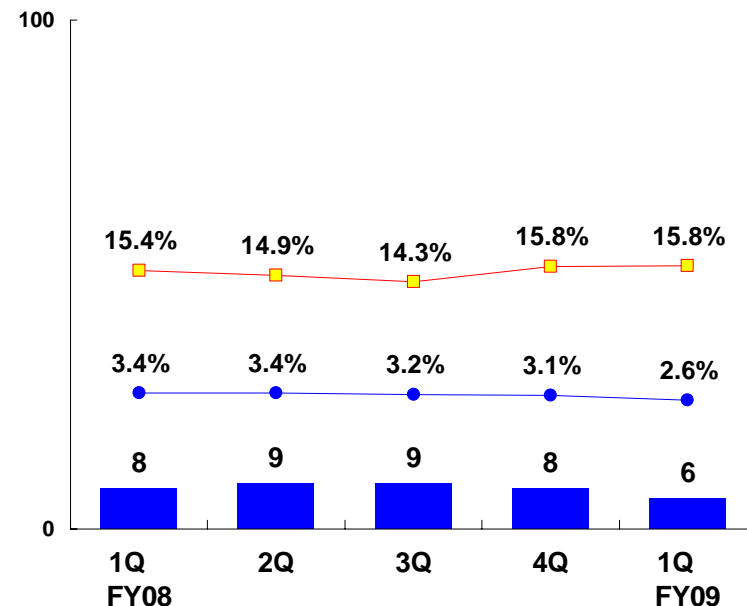
**電子部品・情報通信機器**  
(電子部品、コンピュータ・ネットワーク)

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 □ 売上総利益率

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 □ 売上総利益率

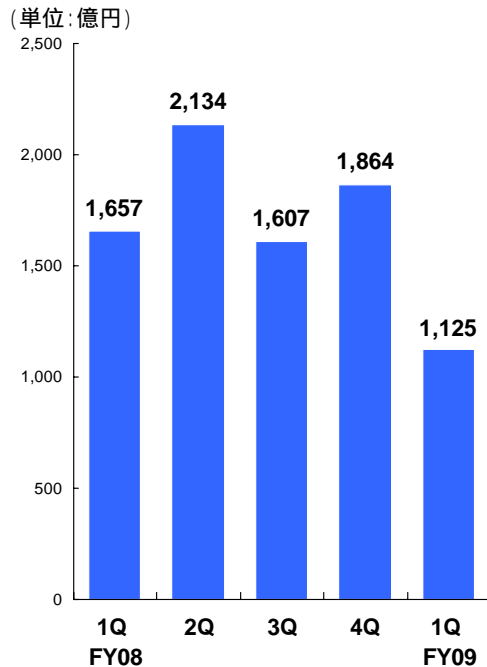
●セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



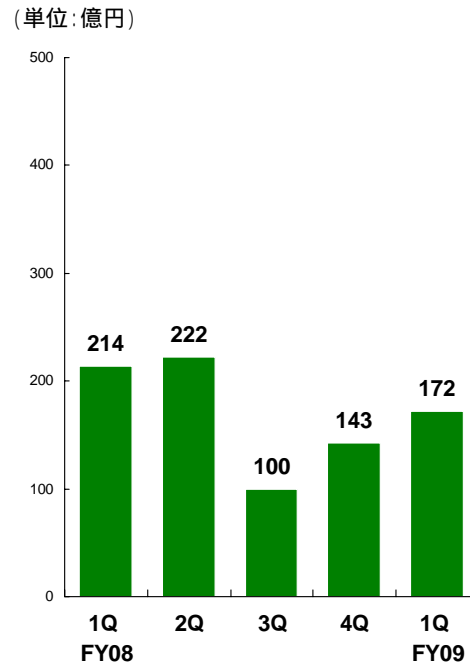
# 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

## 部門別売上高

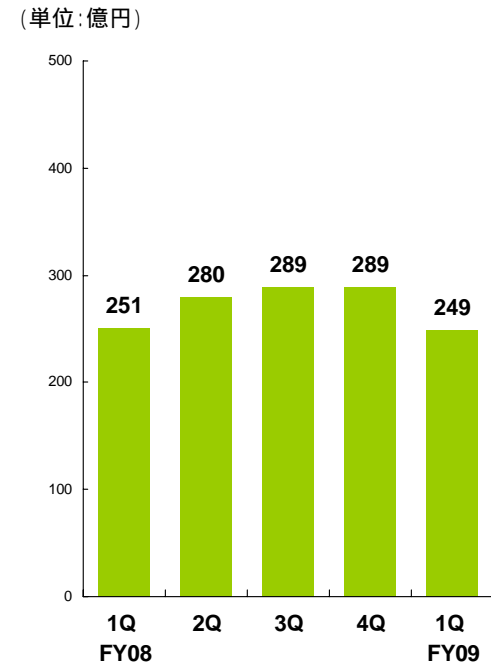
### SPE部門 (半導体製造装置)



### FPD部門 (フラットパネルディスプレイ製造装置)



### EC/CN部門 (電子部品/コンピュータ・ネットワーク)



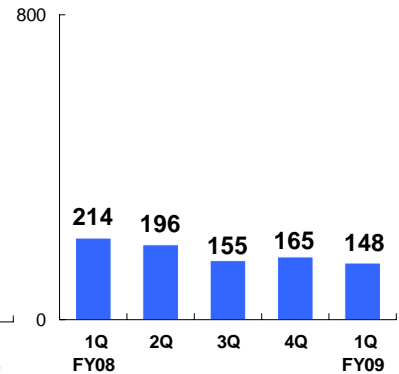
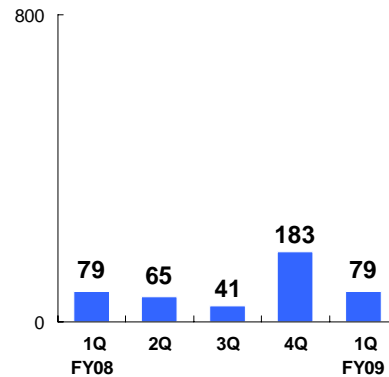
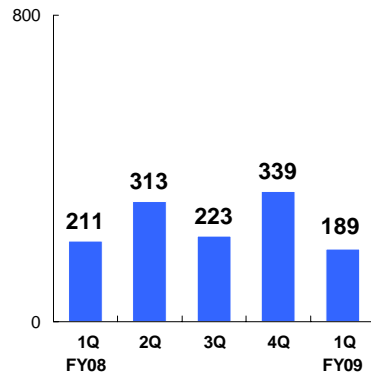
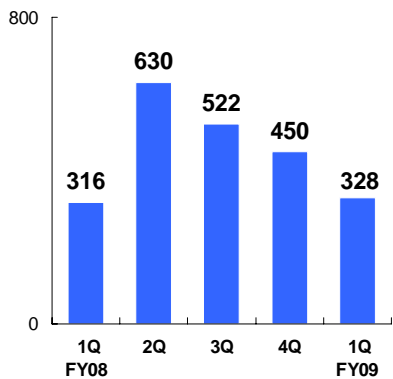
\* 上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります (FY09/1Q売上高1億円未満)。



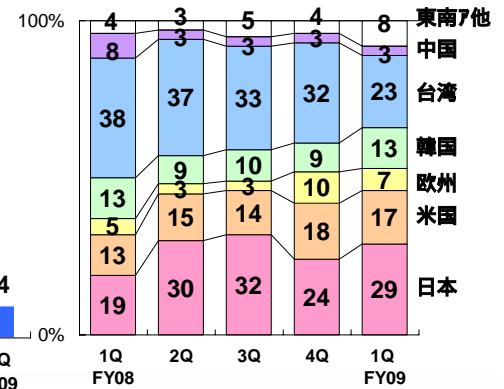
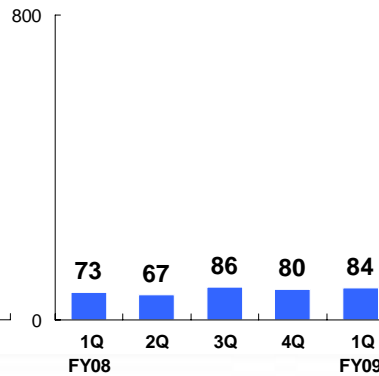
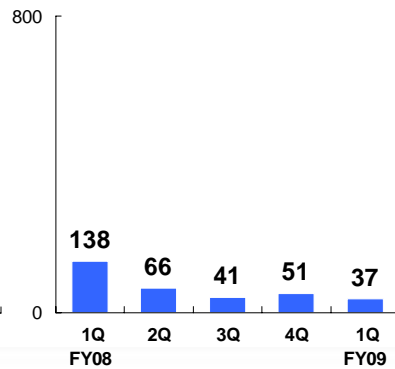
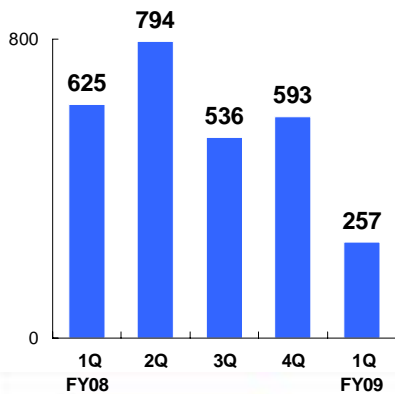
# 2009年3月期 第1四半期決算(連結) S P E 部門地域別売上高

(単位:億円)

## 日本 米国 欧州 韓国



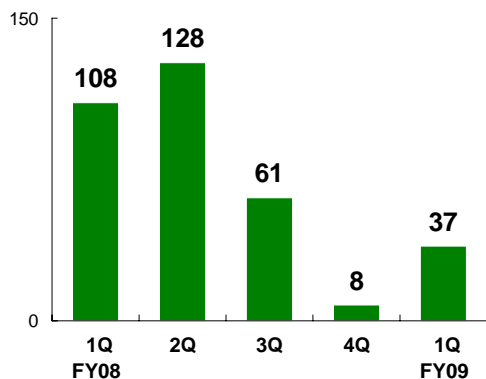
## 台湾 中国 東南アジア他 地域別構成比



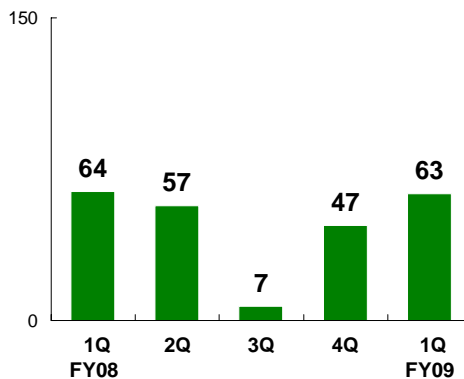
# 2009年3月期 第1四半期決算(連結) FPD部門地域別売上高

(単位:億円)

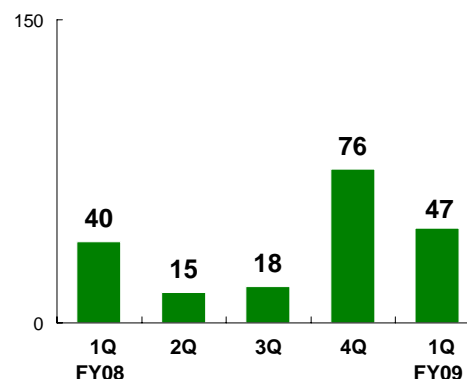
## 日本



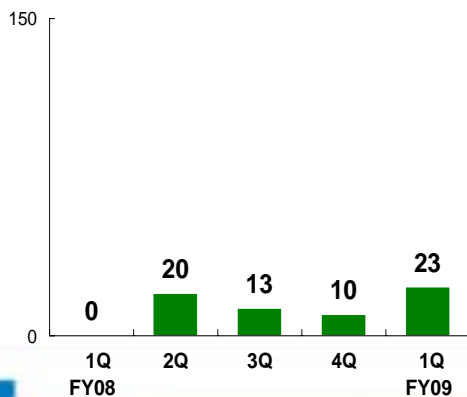
## 韓国



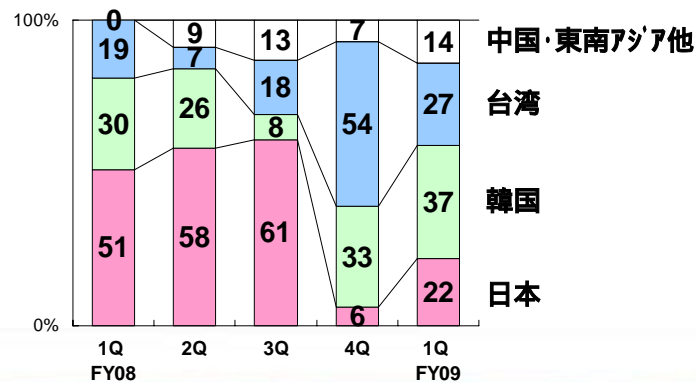
## 台湾



## 中国・東南アジア他



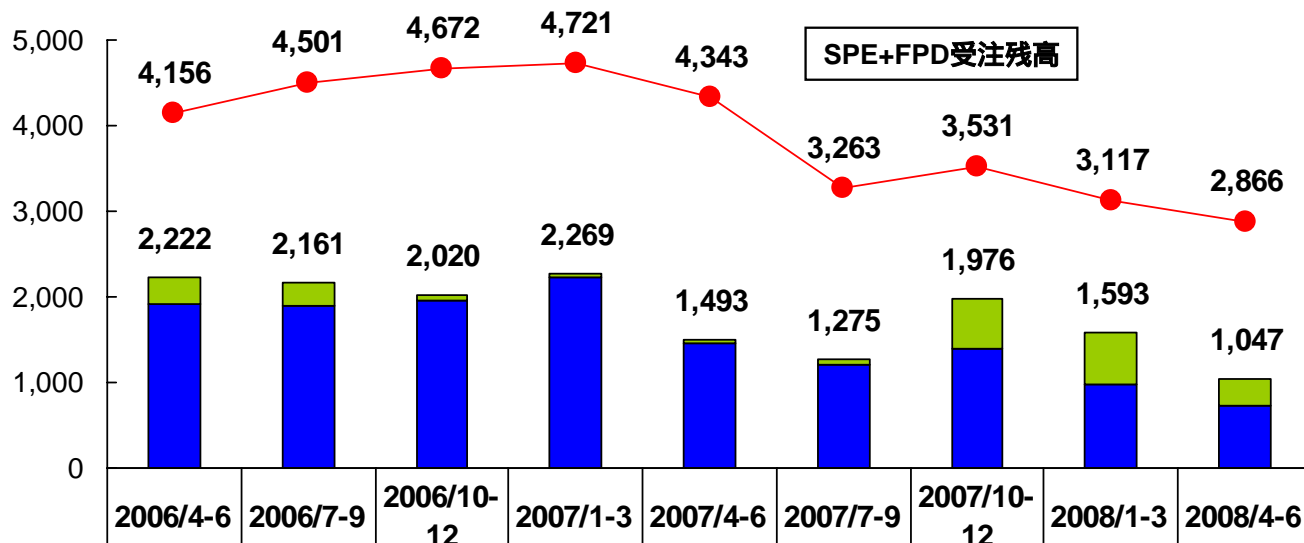
## 地域別構成比



# 2009年3月期 第1四半期決算(連結)

## SPE+FPD受注額, 受注残高

(単位: 億円)



FPD製造装置受注額	296	275	55	42	41	73	573	610	319
半導体製造装置受注額	1,926	1,886	1,964	2,227	1,452	1,202	1,403	983	727
受注額合計	2,222	2,161	2,020	2,269	1,493	1,275	1,976	1,593	1,047
受注残高	4,156	4,501	4,672	4,721	4,343	3,263	3,531	3,117	2,866

### 受注残高内訳

FPD	997	1,036	831	652	479	331	803	1,271	1,417
SPE	3,158	3,464	3,841	4,069	3,864	2,931	2,727	1,846	1,448

